

NDiS・Neu-X・AIEdge-X series

Interactive Signage Platform Product Selection Guide

スマートリテール・サイネージソリューション セレクトカタログ Vol. 5

NDiSシリーズ導入事例

スマートシティコントローラ Neu-Xシリーズ

AIエッジコンピュータ AIEdge-Xシリーズ

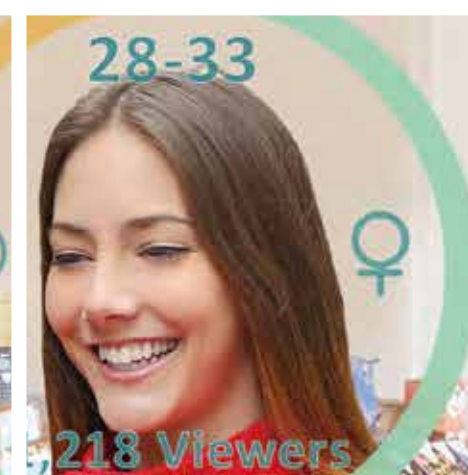
デジタルサイネージプレーヤ NDiS Bシリーズ

マルチディスプレイプレーヤ NDiS Vシリーズ

エンベデッドコンピューティングボード X-Boardシリーズ

国内向けサポートサービスとオプションサービスのご案内

ODMサービス / ネクスコムIoTソリューション



●会社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。●このカタログに記載されている内容は製品改良のため、予告なく仕様・デザイン等を変更する場合があります。●このカタログの記載内容は2021年9月現在のものです。

本製品に関するお問い合わせは



株式会社ネクスコム・ジャパン

〒108-0014 東京都港区芝4-11-5 田町ハラルビル9階
TEL : 03-5419-7830 FAX : 03-5419-7832
Email : sales@nexcom-jp.com
URL : https://www.nexcom-jp.com

2021.09 | NEXCOM Japan www.nexcom-jp.com



NEXCOM導入事例1 マイクロウェーブ展2019

非接触入力プレゼンテーション アプリケーション Neu-X300

ワン空中クリックで
必要な資料をオープン

Presentation
Application

国立研究開発法人
海上・港湾・航空技術研究所
電子航法研究所 展示ブース

非接触入力プレゼンテーションツールで 新しい見せ方を支援する NEXCOM のサイネージ PC

航空交通システムに関する日本唯一の研究機関として、航空の安全性、効率性の向上、地球環境保全などを目指して研究開発に取り組む、国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所の展示ブースでは、NEXCOM のサイネージプレーヤに非接触入力インタフェースを搭載した、プレゼンテーションアプリケーションが使用されました。

現在のコロナ禍に先駆けること 2019 年 11 月、パシフィコ横浜で行われた「マイクロウェーブ展 2019」の出展ブースにおいて、研究成果の発表ツールとして活用された非接触入力アプリケーションは、そのエンターテインメント性と実用性のあるプレゼンテーションで、電子航法研究所の展示ブースに集客と活気をもたらしました。

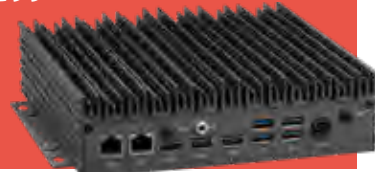
NEXCOM のサイネージ PC に搭載した、リーシス社の非接触入力インタフェース「Ncop 3D」により、Intel® RealSense™ デプス・カメラが指先の動きを検知、来場者が見やすい位置に設置したブース内のモニタに向けて指を動かすことで、プレゼンターは、画面上的 PDF やパワーポイント資料の開閉や、資料ページ送り/戻り、動画の再生などをしながら、モニタに触らず説明やプレゼンテーションを行うことができます。

比較的狭いブース内においても、モニタを見ながら説明を受ける方と、モニタ前の展示品や資料をご覧になる方々との導線を分けることで、モニタ前の混雑緩和が図れ、複数のスタッフによるタッチ操作やマウス操作も、煩雑さや接触に気を取られることなく、ブース対応に集中することができます。また、スタッフが不在の場合でも、来場者が希望の資料を非接触入力操作で閲覧することができ、プレゼン資料との組み合わせで、自社製品の訴求力のある体験型の展示が可能になります。

Neu-X300

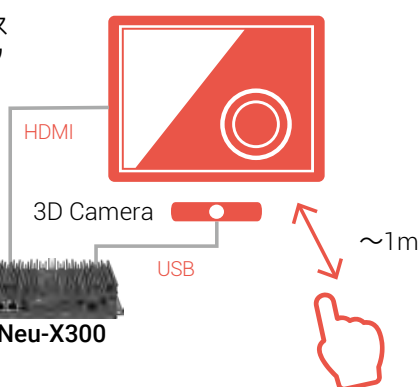
- ・第 8 世代 Intel® Core™ プロセッサ
 - ・Intel® UHD Graphics 630
 - ・4K ビデオ再生対応
- HDMI x 3 (Neu-X300-Q370)
HDMI x 2 (Neu-X300-H310)

非接触入力
インタフェース
「Ncop 3D」



非接触入力インタフェース
Ncop 3D 推奨 PC スペック

- ・CPU : Core i5 2.0GHz
- ・メモリ : 4GB
- ・OS : Windows10



NEXCOM導入事例2 千葉・浦安市

インタラクティブ プロジェクションマッピング NDiS B537

Interactive
Projection
Mapping

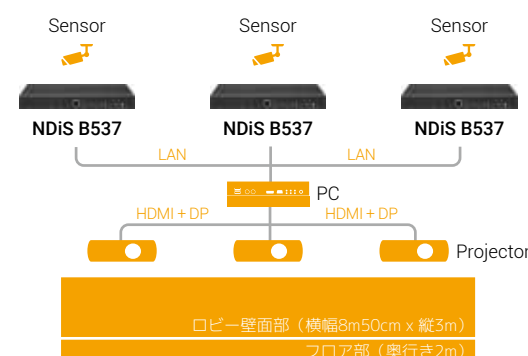
フロントカウンターの混雑緩和を促進し 子供たちが楽しめる空間の提供を助ける NEXCOM の STB

世界でも有数のアミューズメントパークのパートナーホテルであるオリエンタルホテル東京ベイは、主要顧客となるファミリー層の顧客満足度の更なる向上や、受付カウンターでの混雑緩和を目指すと同時に、先進的なデザインを求めた結果、Playful Forest (プレイフルフォレスト) をコンセプトにしたロビー施設のリニューアルに伴い、国内ホテル初となる、インタラクティブプロジェクションマッピングを導入することとなりました。

導入以前は、アミューズメントパークの閉園に合わせてファミリー客が押し寄せていた受付カウンターも、子供たちや同伴のお客様が、プロジェクションマッピングのあるロビー壁面側へ流れることで、混雑が解消され、チェックイン手続きがスムーズに行えるようになり、ロビー全体が宿泊客やレストランの利用客にホテルの施設を十分楽しんでいただける場となっています。

ロビー壁面のスクリーンは、横幅約 8.5m x 高さ 3m、壁面から続くフロア部分は 2m の奥行きがあり、約 7m 手前のガゼボ (休憩施設) 上に設置された 3 台のプロジェクタから、プロジェクションマッピングを投影しています。壁面上部に設置した 3 台の NEXCOM 製 STB (セットトップボックス) で受信したセンシング情報は、Ethernet でレンダリング用の PC に送られ、HDMI や DP ポートを介し接続された 3 台のプロジェクタが、センサで捉えた人物の動きに合わせた映像を出力します。

NEXCOM のファンレス仕様の STB は、フロア部に敷かれたカーペットからの埃にも強く、容易なメンテナンスで長期間にわたって利用いただけます。また、パルコスペースシステムズ社が提供する人気のコンテンツは、特殊な動きで登場する隠れキャラもあり、子供たちに大人気で、2019 年 10 月からは第二弾となるスカイサーカスのインタラクティブプロジェクションマッピングでお客様をお迎えしています。



NDiS B537

- ・第 7 世代 Intel® Core™ プロセッサ
- ・Intel® HD Graphics 630
- ・2 画面ディスプレイ対応 HDMI x2 ポート
- ・薄型ファンレスデザイン

インタラクティブ
プロジェクション
マッピング
「スカイサーカス」



Neu-X

ラインナップ充実
低価格なスマートシティコントローラ
バリューモデルも展開中

Neu-X100 p.7



Neu-X101 p.6



Neu-X300 p.9



Neu-X302 p.8



Xシリーズは、低価格を実現した産業用ファンレス・スマートシティ・コントローラです。デジタルサイネージからゲートウェイまで、インドアユースに適しています。

In-Door

AIEdge-Xシリーズ

AI エッジコンピュータ



Neu-Xシリーズ

エッジコンピューティングシステム



neXServiceシリーズ

オールインワンキヨスク
・ウォールマウント
・テーブル
・スタンド



NDiS Sシリーズ

スマートディスプレイ
モジュールPC



NDiS Mシリーズ

OPSスマートディスプレイPC



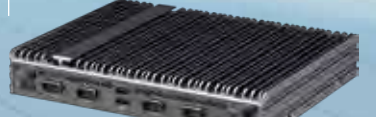
NDiS Vシリーズ

マルチディスプレイ
コンピューティングシステム



NDiS Bシリーズ

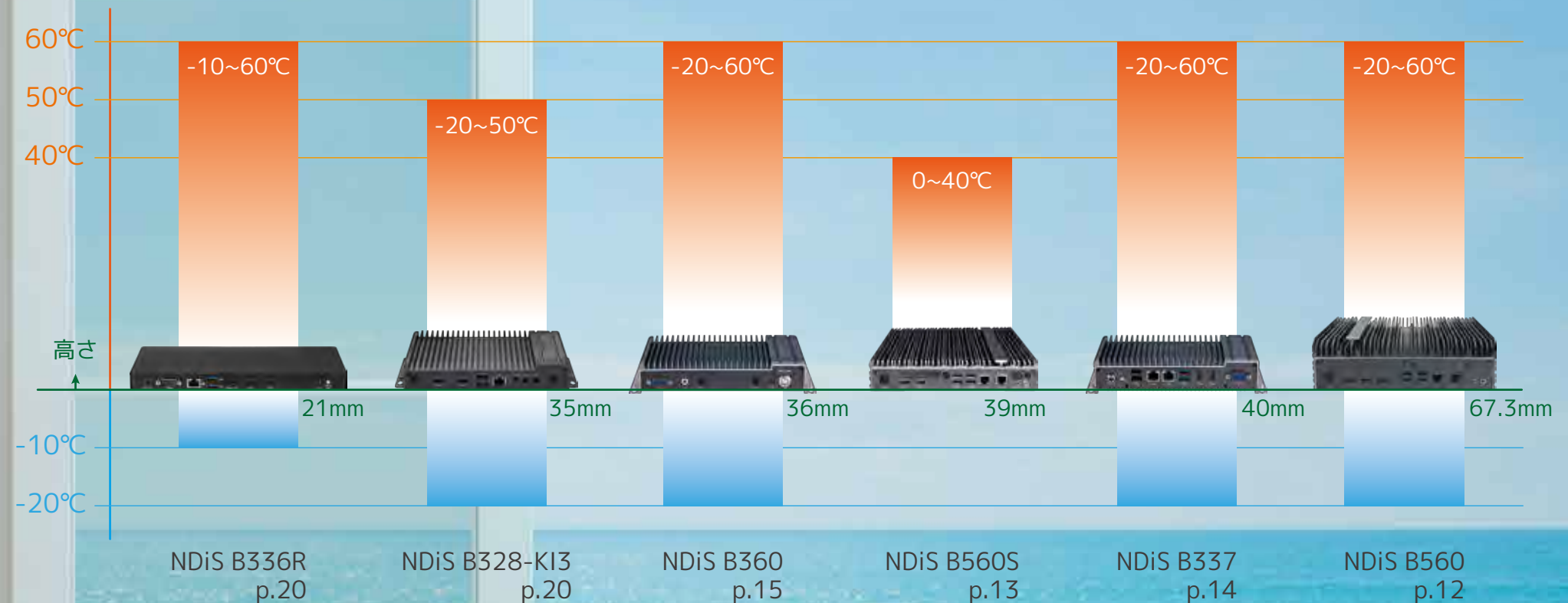
インダストリアル
ビジュアルエンジン



NDiS

Out-Door

ネクスコムフラグシップ高性能 STB
より信頼性の高いビジュアルソリューションを実現



NDiS シリーズは、2009 年のデビュー以来 10 年以上、世界中で運用されているネクスコムのデジタルサイネージ用 STB です。高信頼性をポリシーとし、より広い動作温度範囲や設置しやすい薄型のボディなど、インドアはもちろんアウトドアユースにも適しています。駅や空港をはじめとする公共機関やリテールマーケットなど、設置環境を選びません。

Neu-X101

Neu-X100 追加機種 USBx4 豊富なオプション さらに使いやすくなったスマートシティコントローラ



Neu-X101 は、Neu-X100 と同一のコンパクトサイズを保ちながらも、放熱効果を高め、USB ポート x4 やフロント パワースイッチ、Nano サイズ SIM、オーディオ端子 (オプション)、TPM (オプション)などを追加しました。CPU は Intel® Celeron® J3455 で、低価格を継続しながら、さまざまな用途に導入が可能なスマートシティコントローラ です。デジタルサイネージ、ゲートウェイ、ロガーなど目的を選ばず、ちょっとした組込み機器として手軽に使用で きます。



Neu-X101 前面

ハードウェア追加オプション (背面)

- ・ 2 nd COM x 1 (RS232)
- ・ オーディオ (Line-out)
- ・ TPM 機能



Neu-X101 背面

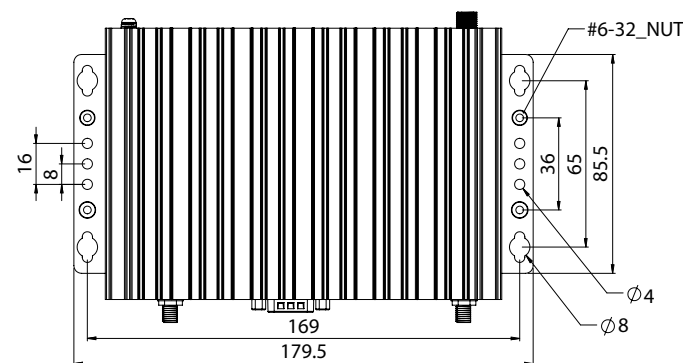
- ・ Intel® Celeron® J3455 (Quad Core, 1.5GHz)
- ・ Intel® HD Graphics 500
- ・ DDR3L SO-DIMMスロット x 1 最大8GB
- ・ RS232/422/485 x 1
- ・ LAN x 2, USB3.0 x 2, USB2.0 x 2

- ・ HDMI 1.4b x 2
- ・ Mini-PCIe スロット x 1
- ・ M.2 x 1 (SSD)
- ・ Nano-SIMスロット x 1
- ・ +12V DC / 60W ACアダプタ付属

外形寸法 155mm (W) x 106mm (D) x 37mm (H)

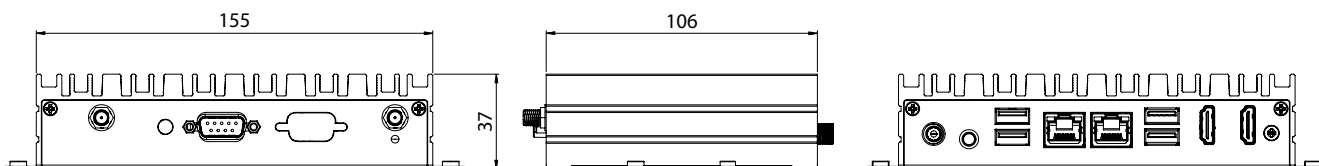
重量 1.0 kg

動作温度範囲 -5℃ ~ 50℃



ODM 例

Neu-X101 の縦と奥行きを大きくして COM x6 に改造した ODM 製品例です。



Neu-X100-N3350/Neu-X100-J3455

新型 Intel® プロセッサ搭載 用途に合わせた 2 タイプのスマートシティコントローラ



Nue-X100 シリーズは、デジタルサイネージのみならず、様々な目的に使用可能な低価格スマートシティコントローラです。2 種類の CPU バリエーションにより、目的に合わせた選択が可能です。デジタルサイネージ用 STB から IoT ゲートウェイまで、使用環境を選ばない超小型で低価格なファンレスコンピュータです。



Neu-X100 前面



Neu-X100 背面

Neu-X100-N3350 :
Intel® Celeron® N3350 (Dual Core, 1.1GHz)
Neu-X100-J3455 :
Intel® Celeron® J3455 (Quad Core, 1.5GHz)

- ・ Intel® HD Graphics 500
- ・ DDR3L SO-DIMMスロット x 1 最大8GB

- ・ RS232/422/485 x 1, LAN x 2, USB3.0 x 2
- ・ HDMI 2.0 x 2
- ・ Mini-PCIe スロット x 1
- ・ M.2 x 1 (SSD)
- ・ SIMスロット x 1
- ・ +19V DC / 45W ACアダプタ付属

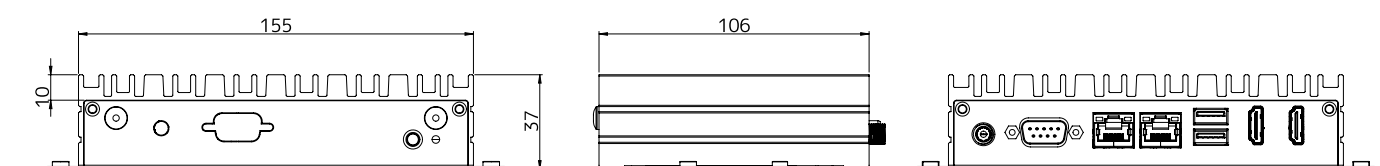
外形寸法 155mm (W) x 106mm (D) x 37mm (H)

重量 0.84 kg

動作温度範囲 -5℃ ~ 50℃

Neu-X100-N3350とJ3455の比較

	Neu-X100-N3350	Neu-X100-J3455
CPU	Celeron® N3350	Celeron® J3455
Core	Dual	Quad
CPU Benchmark	1112	2107
Clock(Turbo speed)	1.1GHz (最大2.4GHz)	1.5GHz (最大2.3GHz)
TDP	6W	10W



Neu-X302-H

第 8/9 世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 COMx6 レガシーなシステムやインダストリアルに



Neu-X302-H は、第 8/9 世代 Intel® Core™ プロセッサを搭載しながら、COM x6、Mic と分割したオーディオポート、今となっては珍しい VGA ポートを備えたコントローラです。旧型モニタをそのまま使用し、コントローラのための交換、2.5 インチ HDD の選択など、FA 等のインダストリアルフィールドや測定器、監視カメラの DVR としても十分に活用いただける、新旧の性能を持ち合わせたコントローラです。オプションにより M.2 による LTE 通信機能も可能です。

CPUタイプ：
Intel® Celeron® G4900T プロセッサ
第8/9世代 Intel® Core™ プロセッサ (35W)
搭載可能CPU：
Core i3-8100T (4 Core, 3.1GHz)
Core i5-8500T (6 Core, 2.1GHz)
Core i7-8700T (6 Core, 2.4GHz)
Core i3-9100TE (4 Core, 2.2GHz)
Core i5-9500TE (6 Core, 2.2GHz)
Core i7-9700TE (8 Core, 1.8GHz)



Neu-X302-H 前面

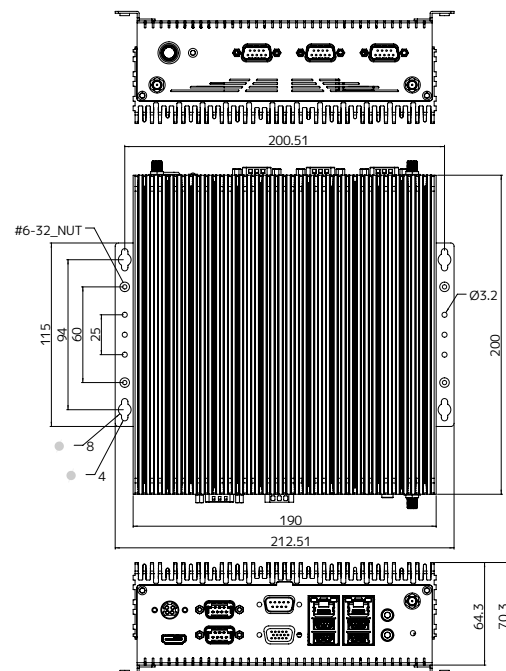
- Intel® H310
- Intel® UHD Graphics 630
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- RS232 x 3, RS232/422/485 x 3, LAN x 2, USB3.0 x 4
- HDMI x 1, VGA x 1

- Line-out x 1, Mic x 1
- 2.5インチベイ x 1
- M.2 x 1 (LTE/SSD 排他的使用)
- SIMスロット x 1
- +12V DC / 96W ACアダプタ付属

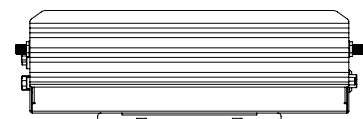
外形寸法 190mm (W) x 200mm (D) x 64.3mm (H)

重量 2.7 kg

動作温度範囲 -5℃～45℃



Neu-X302-H 背面



Neu-X300-Q370/Neu-X300-H310

第 8 世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 4K ビデオ再生対応スマートシティコントローラ



Neu-X300 シリーズは、デジタルサイネージのみならず、様々な目的に使用可能なハイパフォーマンスなスマートシティコントローラです。ソケットタイプの第 8 世代 Intel® Core™ プロセッサを搭載でき、Core™ i7 から Celeron® (オプション) まで目的に合わせて選択いただけます。また 2 種類のチップセットにより、バリュー版と、高性能版を用意しました。

CPUタイプ：
Intel® Celeron® G4900T プロセッサ
第8/9世代 Intel® Core™ プロセッサ (35W)
搭載可能CPU：
Core i3-8100T (4 Core, 3.1GHz)
Core i5-8500T (6 Core, 2.1GHz)
Core i7-8700T (6 Core, 2.4GHz)
Core i3-9100TE (4 Core, 2.2GHz)
Core i5-9500TE (6 Core, 2.2GHz)
Core i7-9700TE (8 Core, 1.8GHz)



Neu-X300-Q370 前面

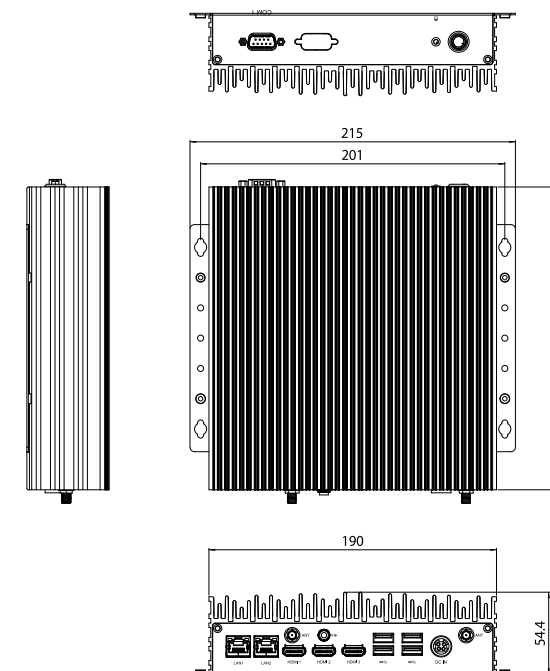
- Neu-X300-Q370 : Intel® Q370
Neu-X300-H310 : Intel® H310
- Intel® UHD Graphics 630
 - DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB

- RS232/422/485 x 1, LAN x 2, USB3.0 x 4
- HDMI x 3 (Q370) / HDMI x 2 (H310)
- Audio-out x 1
- M.2 x 1 (SSD), TPM2.0 (Q370のみ)
- +12V DC / 96W ACアダプタ付属

外形寸法 190mm (W) x 200mm (D) x 54.4mm (H)

重量 2.6 kg

動作温度範囲 -5℃～45℃



Neu-X300 背面

Neu-X300-Q370とH310の比較

	Neu-X300-Q370	Neu-X300-H310
Chipset	Q370	H310
HDMI2.0	3	2
TPM2.0	あり	なし

AIEdge-X300/AIEdge-X300-RTX

第 8/9 世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 大型 GPU を搭載可能な 2 タイプ

AIEdge-X300 は Neu-X300 と同じマザーボードを採用、ファン付きソリューションとして、GeForce や Quadro などの GPU を取り付けるための拡張スロット 2 本を装備しています。本格的な AI 処理やディープラーニング、マルチ画面のデジタルサイネージ用 STB として使用可能です。さらに AIEdge-X300-RTX は、本体の奥行きが 6cm 長く、より大きく高性能な GPU カードが搭載可能です。850W の電源を搭載し、RTX-3090 などの高性能 GPU や NVIDIA A シリーズなどのプロフェッショナルユースの GPU と合わせて使用できます。

CPUタイプ：
Intel® Celeron® G4900T プロセッサ
第8/9世代 Intel® Core™ プロセッサ
搭載可能CPU：
Core i3-8100T (4 Core, 3.1GHz, 35W)
Core i5-8500T (6 Core, 2.1GHz, 35W)
Core i7-8700T (6 Core, 2.4GHz, 35W)
Core i3-9100TE (4 Core, 2.2GHz, 35W)
Core i5-9500TE (6 Core, 2.2GHz, 35W)
Core i7-9700TE (8 Core, 1.8GHz, 35W)
Core i3-8300 (4 Core, 3.7GHz, 65W)
Core i5-8500 (6 Core, 3.0GHz, 65W)
Core i7-8700 (6 Core, 3.2GHz, 65W)
Core i3-9300 (4 Core, 3.7GHz, 65W)
Core i5-9500 (6 Core, 3.0GHz, 65W)
Core i7-9700 (8 Core, 3.0GHz, 65W)

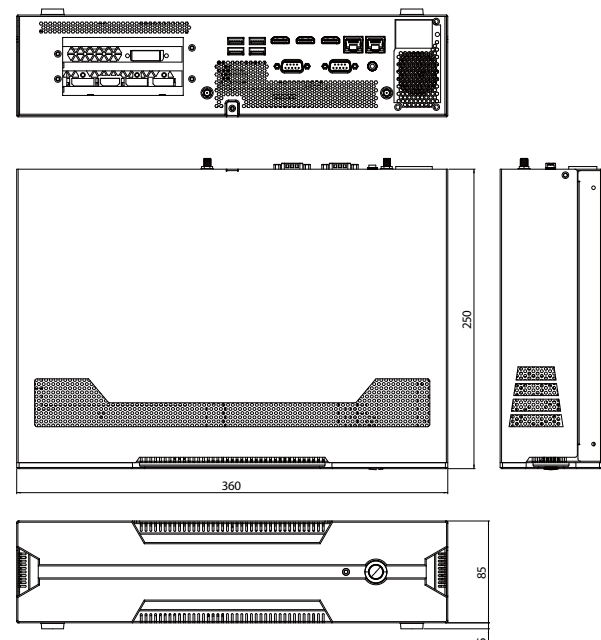


- Intel® Q370 / Intel® UHD Graphics 630
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- RS232 x 1, RS232/422/485 x 1, LAN x 2, USB3.0 x 4
- HDMI x 3, Line-out x 1

- 2.5インチベイ x 1, M.2 x 1 (SSD)
- PCIe(x16) スロット x 1
- +12V DC / 500W (AIEdge-X300-RTXは850W)

外形寸法 AIEdge-X300 : 360mm (W) x 250mm (D) x 85mm (H)
外形寸法 AIEdge-X300-RTX : 360mm (W) x 310mm (D) x 85mm (H)

重量 4.5 kg
重量 5.2 kg
動作温度範囲 0°C ~ 45°C



AIEdge-X300/AIEdge-X300-RTXの比較

	AIEdge-X300	AIEdge-X300-RTX
奥行き(mm)	250	310
電源(W)	500	850
対応NVIDIA GPU	RTX2060まで	RTX3090まで



AIEdge-X300 前面

AIEdge-X500

第 8/9 世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 複数のストレージ&大型 GPU を搭載可能なハイエンドタイプ

AIEdge-X500 は、複数の PCI スロット、2.5 インチベイ x4 を搭載、ハイエンドな AI コントローラやディープラーニングマシンに適しています。効率の良い冷却ファンにより、高性能 GPU や複数の拡張カード、SSD を同時に使用できます。AI 処理プラスαのさらにクリティカルなハイエンドコンピューティングが可能です。

CPUタイプ：第8/9世代 Intel® Core™ プロセッサ
搭載可能CPU：
Core i3-8300 (4 Core, 3.7GHz, 65W)
Core i5-8500 (6 Core, 3.0GHz, 65W)
Core i7-8700 (6 Core, 3.2GHz, 65W)
Core i3-9300 (4 Core, 3.7GHz, 65W)
Core i5-9500 (6 Core, 3.0GHz, 65W)
Core i7-9700 (8 Core, 3.0GHz, 65W)



AIEdge-X500 背面

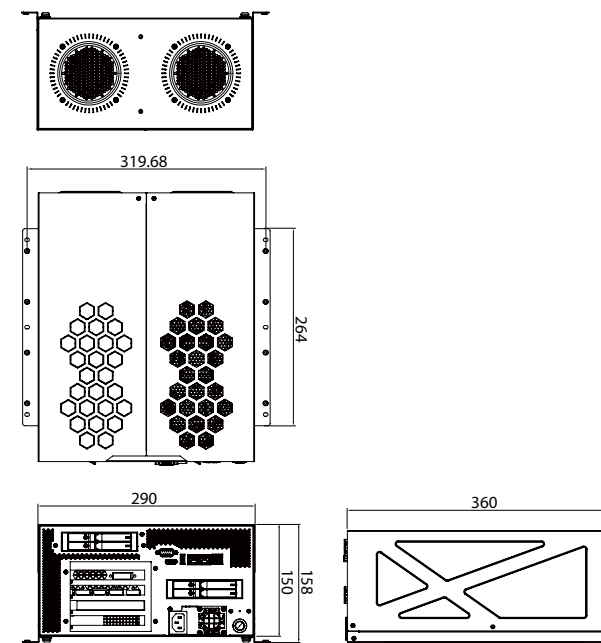
- Intel® Q370 / Intel® UHD Graphics 630
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- RS232/422/485 x 1, LAN x 2
- USB3.0 x 2, USB2.0 x 1

- HDMI x 1
- 2.5インチベイ x 4, M.2 x 1 (SSD)
- PCIe(x16) スロット x 1, PCIe(x4) スロット x 1, PCI スロット x 1
- +12V DC / 800W

外形寸法 290mm (W) x 360mm (D) x 150mm (H)

重量 7.6 kg

動作温度範囲 0 ~ 45°C



AIEdge-X500 前面

NDiS B560

第 8/9 世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 広温度対応 屋外のデジタルサイネージやキオスク機器向け



NDiS B560 は -20℃～ 60℃に対応するデジタルサイネージ STB です。COM x4、HDMI x3 を搭載しており、屋外設置の高性能デジタルサイネージ STB としても、また豊富な COM ポートにより、キオスクや POS レジのコントローラとしても使用可能です。インダストリアルフィールドでの使用にも十分な性能を兼ね備えています。

CPUタイプ：第8/9世代 Intel® Core™ プロセッサ (35W)

搭載可能CPU：

Core i3-8100T (4 Core, 3.1GHz)
Core i5-8500T (6 Core, 2.1GHz)
Core i7-8700T (6 Core, 2.4GHz)
Core i3-9100TE (4 Core, 2.2GHz)
Core i5-9500TE (6 Core, 2.2GHz)
Core i7-9700TE (8 Core, 1.8GHz)



NDiS B560

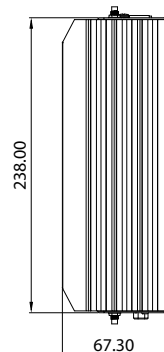
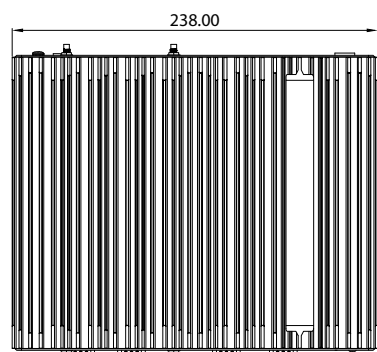
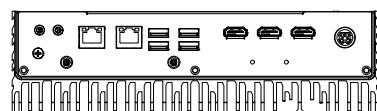
- Intel® Q370
- Intel® UHD Graphics 630
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB (1スロット最大16GB)
- RS232 x 3, RS232/422/485 x 1, LAN x 2, USB3.0 x 6
- HDMI x 3, Line-out x 1, Mic x 1

- M.2 x 1 (LTE)
- 2.5インチベイ x 1, M.2 x 1 (SSD)
- SIMスロット x 1
- +12V DC / 96W ACアダプタ付属

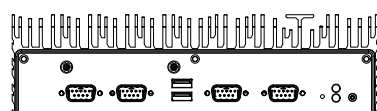
外形寸法 238mm (W) x 192mm (D) x 67.3mm (H)

重量 3.5 kg

動作温度範囲 -20℃～ 60℃



NDiS B560 背面



NDiS B560S

第 8/9 世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 スリム型のデジタルサイネージやキオスク機器向け



NDiS B560S は、NDiS B560 と同じマザーボードを搭載し、スリムケースに変更したことにより、使用温度範囲は 0℃～ 40℃と狭くなりますが、設置性に優れ、薄型を好むデジタルサイネージ STB 設置環境の要求を満たしています。NDiS B560 と同じ I/O ポートを搭載しており、POS キオスクでも活躍します。

CPUタイプ：第8/9世代 Intel® Core™ プロセッサ (35W)

搭載可能CPU：

Core i3-8100T (4 Core, 3.1GHz)
Core i5-8500T (6 Core, 2.1GHz)
Core i7-8700T (6 Core, 2.4GHz)
Core i3-9100TE (4 Core, 2.2GHz)
Core i5-9500TE (6 Core, 2.2GHz)
Core i7-9700TE (8 Core, 1.8GHz)



NDiS B560S

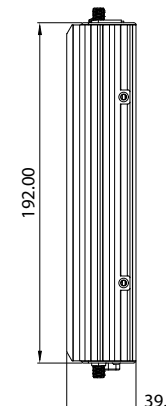
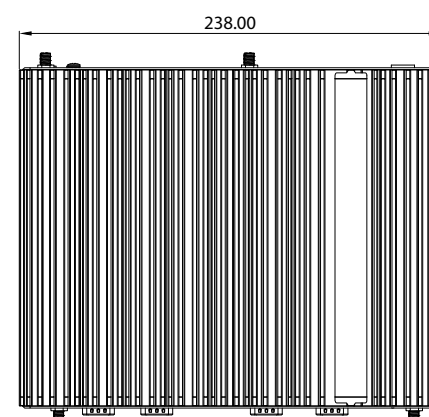
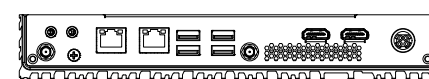
- Intel® H310
- Intel® UHD Graphics 630
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB (1スロット最大16GB)
- RS232 x 3, RS232/422/485 x 1, LAN x 2
- USB3.0 x 4, USB 2.0 x 2

- HDMI x 2, Line-out x 1, Mic x 1
- M.2 x 1 (LTE)
- 2.5インチベイ x 1, M.2 x 1 (SSD)
- SIMスロット x 1
- +12V DC / 96W ACアダプタ付属

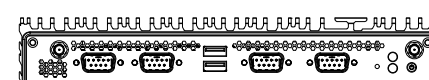
外形寸法 238mm (W) x 192mm(D) x 39mm (H)

重量 2.3 kg

動作温度範囲 0℃～ 40℃



NDiS B560S 背面



NDiS B337

Intel® Celeron® J3455 プロセッサ搭載 広温度対応 シンプルでエントリーレベルの STB



NDiS B337 は、Neu-X101 とほぼ同等のスペックですが、放熱効果の高い専用のケースを採用したことで、同一 CPU ながら使用温度範囲は -20℃～60℃と、車載用 PC に近い温度特性を兼ね備えています。Intel® Celeron® J3455 プロセッサ搭載のため、極端に高速な描画には向きませんが、屋外での 2 画面の（動画を含む）一般的なデジタルサイネージに適しています。



NDiS B337

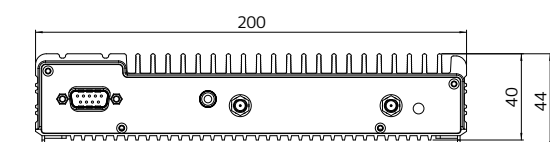
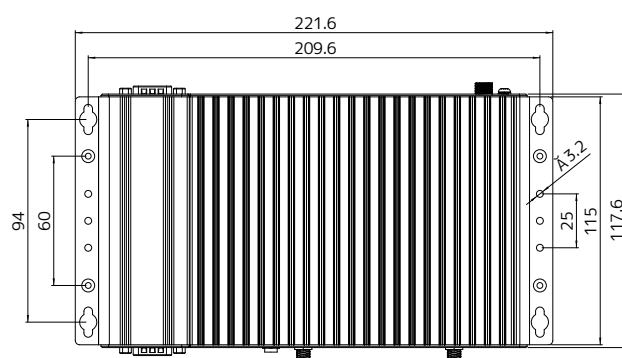
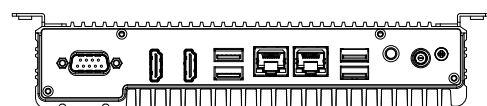
- Intel® Celeron® J3455 (Quad Core, 1.5GHz)
- Intel® HD Graphics 500
- DDR3L SO-DIMM スロット x 1 最大8GB
- RS232 x 1, RS232/422/485 x 1, LAN x 2
- USB3.0 x 2, USB2.0 x 2

- HDMI x 2, Audio x 1
- Mini-PCIe スロット x 1
- M.2 x 1 (SSD)
- Nano-SIMスロット x 1
- +12V DC / 60W ACアダプタ付属

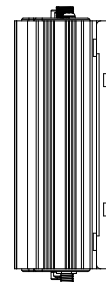
外形寸法 200mm (W) x 117.6mm (D) x 40mm (H)

重量 1.3 kg

動作温度範囲 -20℃～60℃



NDiS B337 背面



NDiS B360

第 11 世代 Intel® 新型 Core™ プロセッサ搭載 TDP 15W / 10nm でより軽やかな動作性能

NDiS B360 は、第 11 世代 Intel® Core™ i3-1115G4E または Core™ i5-1145G7E プロセッサをオンボードで搭載した最新型 STB です。10 nm SuperFin により、グラフィック性能も一段とレベルアップし、Core i3 でも Celeron J3455 の約 3 倍の CPU パワーを有するため、ほとんどのコンテンツを無理なく再生可能です。HDMI ポートと DP ポートを搭載しており、モニタを選びません。また、新シリーズの XPPC10-200 シリーズとマザーボードを共有化することにより、コストダウンも実現しました。同一シリーズの Celeron 6305E と Core i7-1185G7E 搭載モデルは ODM により承ります。リテールからインダストリアルまで、あらゆるフィールドで採用いただけます。



NDiS B360

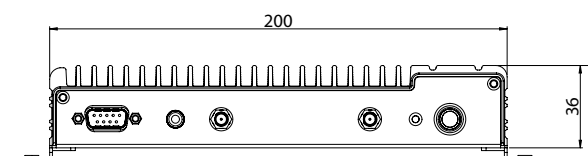
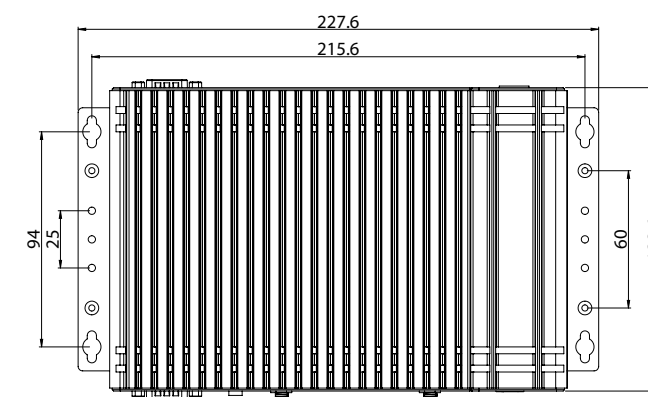
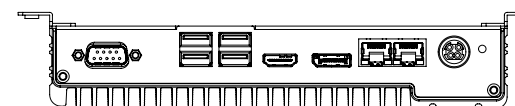
- NDiS B360-i3 :**
Intel® Core™ i3-1115G4E (Dual Core, 2.2GHz)
- NDiS B360-i5 :**
Intel® Core™ i5-1145G7E (Quad Core, 1.5GHz)

- DDR4 SO-DIMM スロット x 1 最大32GB
- RS232 x 1, RS232/422/485 x 1, LAN x 2, USB3.0 x 4
- HDMI x 1, DisplayPort++ x 1, Line-out x 1
- M.2 x 1 (SSD)
- +12V DC / 60W ACアダプタ付属

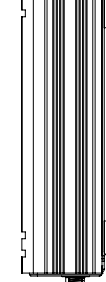
外形寸法 200mm (W) x 132.6mm(D) x 36mm (H)

重量 1.3 kg

動作温度範囲 -20℃～60℃



NDiS B360 背面



NDiS B116/NDiS B116-4G-16G

ARM® Cortex®-A72 x2 & Cortex®-A53 x4 搭載 広温度範囲スリム型ヘキサコアサイネージ PC 2 タイプ

ARM® Cortex®-A72 デュアルコアおよび Cortex®-A53 クアッドコアを搭載した NDiSB116 は、低消費電力でリッチなマルチメディアコンテンツを再生できます。コンパクトなシャーシに収められており、LCD TV や HDMI ディスプレイ出力（最大 HDMI2.0 サポート 4K2K60Hz）を備えた環境での使用や、ギガ LAN などのディスプレイデバイスに簡単に統合できます。NDiS B116 は、広告、メッセージング、およびブランドプロモーション用のエントリーレベルのデジタルサイネージプレーヤとして適しています。



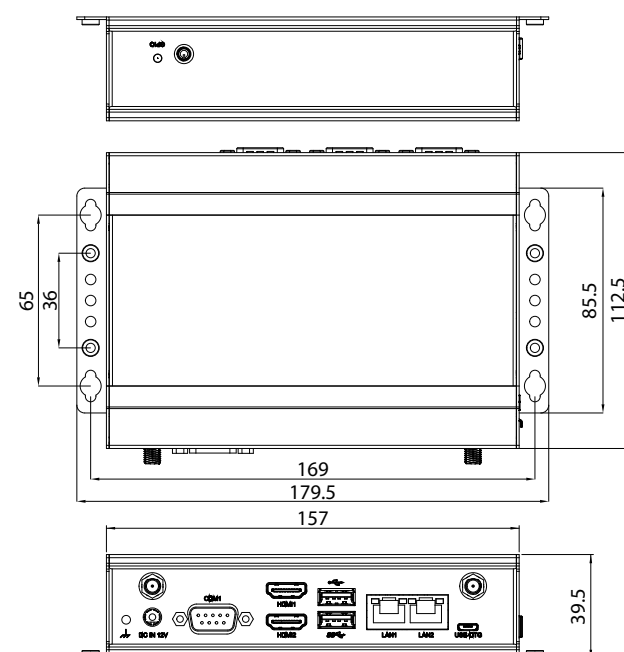
NDiS B116

- Rockchip RK3399 64bit
- ARM® Cortex®-A72 x2 & Cortex®-A53 x4 Mail-T864 GPU
- LPDDR4 2GB 実装済み eMMC 8GB 実装済み
- RS232/422/485 x 1, LAN x 2
- USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1, USB OTG x 1
- HDMI x 2
- Mini-PCIe スロット x 1
- Nano-SIMスロット x 1
- +12V DC / 60W ACアダプタ付属

外形寸法 180mm (W) x 113mm (D) x 40mm (H)

重量 0.8 kg

動作温度範囲 0°C ~ 60°C

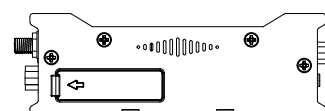


NDiS B116とNDiS B116-4G-16Gの比較

	NDiS B116	NDiS B116-4G-16G
メモリ（実装済み）	LPDDR4 2GB	LPDDR4 4GB
eMMC（実装済み）	8GB	16GB
COM	RS232/422/485 x 1	RS232/422/485 x 1 RS232 x 3



NDiS B116 背面



NDiS V1000

AMD Ryzen™ V シリーズ Quad Core プロセッサ搭載 マルチディスプレイエンベデッドコンピュータ

NDiS V1000 は、高性能でハイコストパフォーマンスな AMD Ryzen 組込み型 V1000 プロセッサファミリの V1605B を搭載し、「Zen」CPU と「Vega」GPU アーキテクチャによる最新型 SoC により、高性能なグラフィックスとマルチメディア処理を実現しました。4 ポートの HDMI によりインパクトのある多彩な表現が可能となります。小型でハイパフォーマンスなファンレス STB です。



NDiS V1000

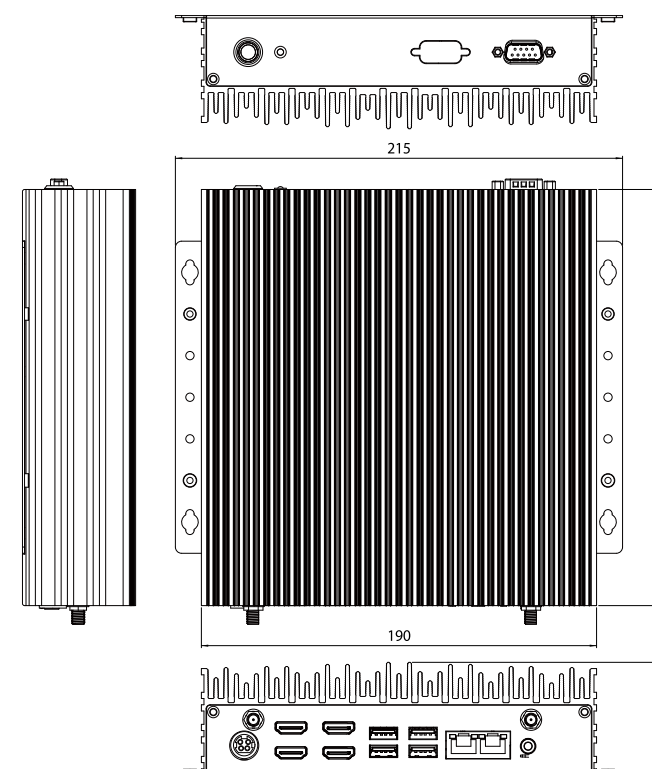
NDiS V1000 背面

- AMD Ryzen™ V1605B (Quad Core, 2GHz)
- AMD Radeon™ Vega 8 Graphics
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- RS232/422/485 x 1, LAN x 2
- USB3.0 x 4
- HDMI x 4, Line-out x 1
- M.2 x 1 (SSD)
- +12V DC / 120W ACアダプタ付属

外形寸法 190mm (W) x 200mm (D) x 54.4mm(H)

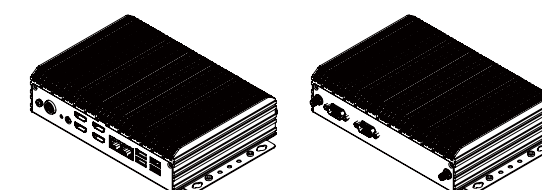
重量 2.6 kg

動作温度範囲 0°C ~ 40°C



NDiS V1100

最新第 11 世代 Intel® Core™ プロセッサで
パフォーマンス 50% UP & 40% サイズダウン



- 第11世代 Intel® Core™ プロセッサ
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- RS232 x 1, RS232/422/485 x 1, LAN x 2, USB3.0 x 4
- HDMI x 4, Line-out x 1, Mic x 1
- Mini-PCIe スロット x 1
- GPIO コネクタ x 1 (入力3点/出力3点)
- M.2 x 2 (SSD)
- +12V DC / 96W ACアダプタ付属
- 190mm (W) x 135mm (D) x 48mm(H)
- 0°C ~ 45°C

NDiS B537

第7世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 4K ビデオ再生対応スリム型デジタルサイネージプレーヤ



NDiS B537 は、第7世代 Intel® Core™ プロセッサを搭載し、従来機（NDiS B535）に比べ約10%の性能向上を実現しました。さらにケースも従来の52mmから33mmへと約35%スリム化し、よりフレキシブルな設置を可能とします。オプションのLTE モジュールを搭載すると直接通信可能となり、STBのみならず高性能デジタルサイネージ向けIoT ゲートウェイとしても使用可能です。



NDiS B537

CPUタイプ：第7世代 Intel® Core™ プロセッサ
搭載可能CPU：
Core i3-7101E (Dual Core, 3.9GHz)
Core i5-7500T (Quad Core, 2.7GHz)
Core i7-7700T (Quad Core, 2.9GHz)

• Intel® H110

- Intel® Graphics HD630
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- RS232 x 2, LAN x 1, USB3.0 x 4
- HDMI x 2, Line-out x 1, Mic x 1
- Mini-PCIe スロット x 1, M.2 x 1 (LTE)
- 2.5インチベイ x 1
- SIMスロット x 1
- +12V / 96W ACアダプタ付属

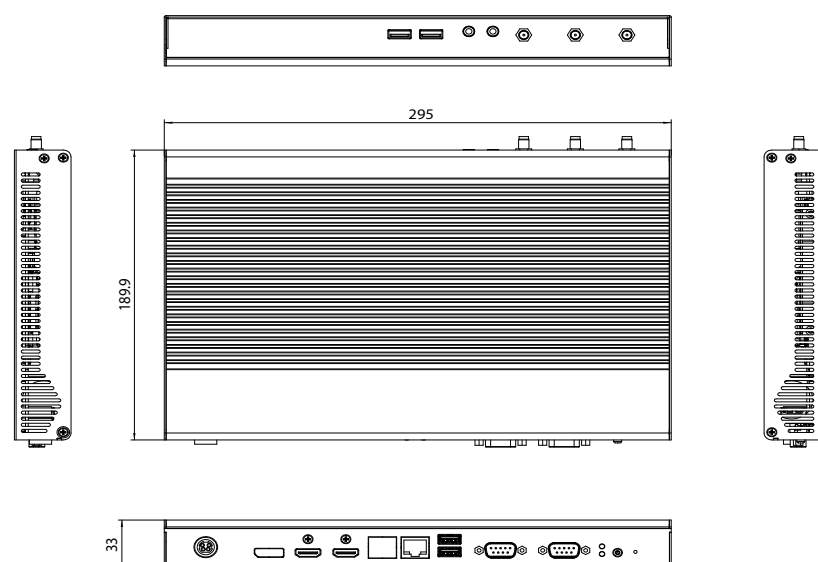
外形寸法 295mm (W) x 189.9mm (D) x 33mm (H)

重量 2.5 kg

動作温度範囲 -10℃～45℃



NDiS B537 背面



NDiS B535

第6世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 4K ビデオ再生対応デジタルサイネージプレーヤ



NDiS B535 は B533 を継承し、同一デザインに第6世代 Intel® Core™ プロセッサを搭載、Intel® HD530 Graphics により、4K のマルチ出力の多彩な映像表現を可能にしました。ケースにはアルミを使用し、ファンレスとしての放熱に重点をおいて設計しました。さらにオプションでケース内に2個のファンが搭載可能で、劣悪な温度環境にも対応いたします。



NDiS B535

CPUタイプ：第6世代 Intel® Core™ プロセッサ
搭載可能CPU：
Core i3-6100TE (Dual Core, 2.7GHz)
Core i5-6500TE (Quad Core, 2.3GHz)
Core i7-6700TE (Quad Core, 2.4GHz)

• Intel® Q170

- Intel® Graphics HD530
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- RS232 x 4, LAN x 2, USB3.0 x 6
- HDMI x 3, Line-out x 1, Mic x 1
- Mini-PCIe スロット x 1, M.2 x 1 (LTE)
- 2.5インチベイ x 1, M.2 x 1 (SSD)
- SIMスロット x 1
- +12V / 96W ACアダプタ付属

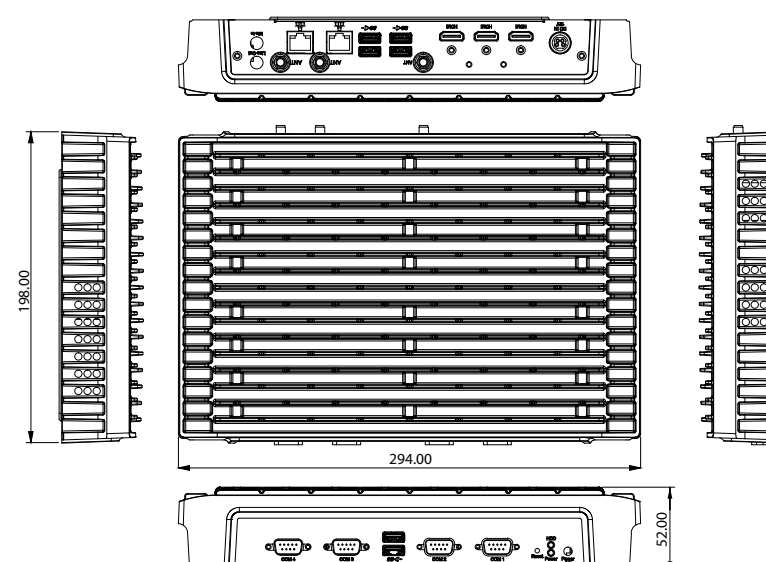
外形寸法 294mm (W) x 198mm(D) x 52mm (H)

重量 3.5 kg

動作温度範囲 0℃～40℃



NDiS B535 背面



NDiS B328-KI3

第 7 世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 4K ビデオ再生対応デジタルサイネージプレーヤ

NDiS B328-KI3 は、第 7 世代 Intel® Core™ i3-7100U をオンボードで搭載し、バリューとハイパフォーマンスの中間的な存在で、一般的なデジタルサイネージのほとんどに対応できます (Intel® HD620 Graphics)。価格と消費電力 (TDP 15W) を抑えたミドルレンジ仕様で、ストレージは底面より交換可能、高メンテナンス性と薄型のスタイリッシュなデザインを兼ね備えたファンレス STB です。



NDiS B328-KI3

NDiS B328-KI3 背面

- Intel® Core™ i3-7100U (Dual Core, 2.4GHz)
- Intel® Graphics HD620
- DDR4 SO-DIMM スロット x 2 最大32GB
- RS232 x 1, LAN x 1, USB3.0 x 6

- HDMI x 2, Line-out x 1, Mic x 1
- 2.5インチベイ x 1, M.2 x 1 (SSD)
- +19V ACアダプタ付属

外形寸法 224.4mm (W) x 147.4mm (D) x 35mm (H)

重量 1.5 kg

動作温度範囲 -20℃～50℃ (SSD) ; 0℃～50℃ (HDD)

NDiS B336R

Intel® Atom™ E3950 プロセッサ搭載 ハイパフォーマンス STB

NDiS B336R は、最新 Intel® Atom™ プロセッサ E3950 を搭載、高さ 21mm の超薄型デジタルサイネージ向け STB です。薄型のため、設置の際のレイアウトが容易になります。Intel® HD505 Graphics を搭載し、エントリーレベル (シンプルなインターフェース) ながらも、フレキシブルな使い方が可能です。



NDiS B336R



NDiS B336R 背面

- Intel® Atom™ E3950 (Quad Core, 2.0GHz)
- Intel® Graphics HD505
- DDR3L SO-DIMM スロット x 2 最大16GB
- RS232 x 1, LAN x 1, USB3.0 x 5
- HDMI x 2, DisplayPort x 1, Line-out x 1, Mic x 1

- Mini-PCIe スロット x 1, M.2 x 1 (LTE)
- 2.5インチベイ x 1
- SIMスロット x 1
- +19V / 65W ACアダプタ付属

外形寸法 259mm (W) x 147mm (D) x 21mm (H)

重量 1.3 kg

動作温度範囲 -10℃～60℃ (SSD) ; 0℃～40℃ (HDD)

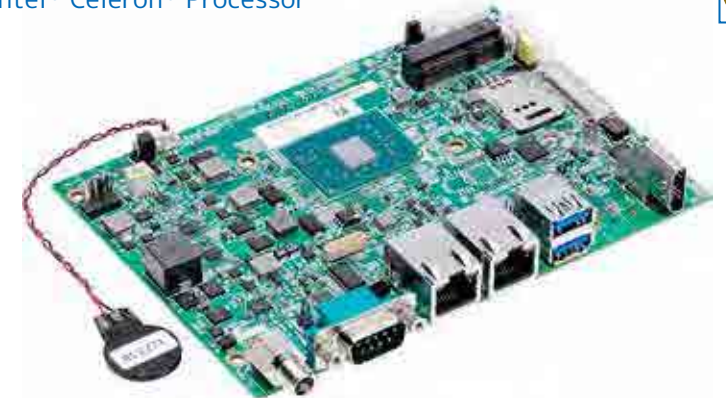
特別企画：Neu-X100 と Neu-X300 のマザーボードのみをリリース

スマートシティコントローラ Neu-X100/Neu-X300 に搭載のマザーボードを単体でご提供する特別企画です。ファン付システムや既存のマザーボードから高性能で安価な製品に置き換える等の要求が高まっていることから、今回企画商品として販売いたします。メモリや SSD、CPU (X300) も併せて動作確認後に出荷することも可能です。

X100-N3350-P/J3455-P

X Embedded Computing Board powered by Intel® Celeron® Processor

スマートシティコントローラ Neu-X100 に搭載の 3.5 インチサイズマザーボード単体での提供です。2 種類の CPU (Dual Core/Quad Core) から選択可能です。性能は Neu-X100 と同一です。



- Intel® Celeron® N3350/J3455プロセッサ
- DDR3L SO-DIMM スロット x 1 最大8GB
- RS232/422/485 x 1, LAN x 2, USB3.0 x 2
- HDMI x 2, LVDS x 1

- Mini-PCIe スロット x 1
- M.2 x 1 (SSD)
- SIMスロット x 1
- +12V/19V DC

X300-Q370/H310

X Embedded Computing Board powered by Intel® Core™ Processor

スマートシティコントローラ Neu-X300 に搭載の Mini-ITX サイズのマザーボードです。2 種類のチップセットから選択可能です。TPM を搭載した上位機種 X300-Q370 と低価格の X300-H310。CPU は 8th と 9th の Core プロセッサから選択でき、出荷時に搭載してご提供することもできます。

CPUタイプ：
Intel® Celeron® G4900T プロセッサ
第8/9世代 Intel® Core™ プロセッサ
搭載可能CPU：
Core i3-8100T (4 Core, 3.1GHz, 35W)
Core i5-8500T (6 Core, 2.1GHz, 35W)
Core i7-8700T (6 Core, 2.4GHz, 35W)
Core i3-9100TE (4 Core, 2.2GHz, 35W)
Core i5-9500TE (6 Core, 2.2GHz, 35W)
Core i7-9700TE (8 Core, 1.8GHz, 35W)
Core i3-8300 (4 Core, 3.7GHz, 65W)
Core i5-8500 (6 Core, 3.0GHz, 65W)
Core i7-8700 (6 Core, 3.2GHz, 65W)
Core i3-9300 (4 Core, 3.7GHz, 65W)
Core i5-9500 (6 Core, 3.0GHz, 65W)
Core i7-9700 (8 Core, 3.0GHz, 65W)



- DDR4 SO-DIMM スロット x 1 最大32GB
- RS232/422/485 x 1, RS232 x 2, LAN x 2
- USB3.0 x 4, USB2.0 x 4 (Q370)
- USB3.0 x 4, USB2.0 x 2 (Q310)
- HDMI x 3 (Q370) / HDMI x 2, LVDS x 1 (H310)

- Line-out x 1, Mic-in x 1
- GPIOコネクタ x 1 (入力4点/出力4点)
- PCIe(x16) x 1, TPM2.0 (Q370)
- M.2 x 1 (SSD)
- +12V DC Mini-ITXサイズ

充実の国内向けサポートメニュー

ミニマムロットは1台から 1台より受注 最低発注数は、システム1台より承ります。	面倒な組立てはお任せ アセンブリサービス ご希望のCPU、メモリ、ストレージ、拡張カードなど、各種アセンブリサービスもお任せ下さい。	各種キッティング インストール・キッティング ご希望のOS・アプリケーションのインストール、ご指定のCDなどの添付品の同梱等、各種キッティング作業も承ります。
信頼性を高めます 出荷前検査の実施 出荷前にエージングテスト、負荷テスト等を実施します。貴社ご指定の検査や評価レポートの添付などにも対応します。	安心の国内サポート 修理・技術サポート 修理や技術サポートを実施します。修理レポートの作成など、国内でのサポート体制を整えています。	貸出無料 評価機貸出 ネクスコムの製品を無料にてお貸出しします。導入前のパフォーマンスの確認や評価にご利用ください。

修理サポートサービス

18ヶ月間の無償修理保証（標準保証） 標準品は弊社発送日より18ヶ月間の無償修理保証が添付されています。（保証書を発行しない出荷履歴管理システムにより、出荷商品の詳細は弊社で管理しております）	国内での修理対応 ネクスコム・ジャパンにて修理が可能な場合は、国内修理により短期間にて返却します。
センドバックによる受付 修理品を弊社まで発送頂き、弊社にて不良状況の確認・解析・修理を実施します。	本社（NEXCOM International）での修理対応 ネクスコム・ジャパンにて修理が不可能な場合は、本社のRMAセンターへ発送します。

その他オプションサービス

最長5年延長保証のオプションサポート ワランティプログラム ネクスコム・ジャパン ワランティプログラムは、NDiSシリーズ等の弊社製品をシステムで購入いただいた際に、所定の費用を購入時、お支払いいただくことにより、最長5年間修理費用が無償になるプログラムです。 ※詳細は別紙ワランティ規定をご覧ください。	USBでメモリブートし、簡単リカバリ リカバリ USB メモリ添付サービス 製品を購入時にリカバリ USB メモリ添付サービスをオプションにてご利用頂けます。出荷時に Windows イメージ USB メモリにリカバリして添付しますので、障害発生時に出荷時の状態に簡単に復旧することができます。また、お客様のアプリケーション等を含めたオリジナルのリカバリイメージを何回でも作成可能です。お客様でイメージを作成するパラゴンライト（USB メモリとパラゴンソフトウェアのみ）も低価格でご用意しています。（※ Windows OS のみ対応となります。日本語版が標準ですが、英語版も対応可能です。）
何回でも修理費無料！ 年8%とリーズナブル 2,3,4,5年間の選択可 1台から対応	NeW パラゴンライト 新登場
標準保証 18か月 延長保証（オプション） 最大5年間	安心の 延長保証 【USB リカバリの資料】 NEXCOM テクニカルサポートページ カタログ・マニュアルダウンロード 



カラーチェンジやインターフェースのカスタマイズ ステッカー製作などオリジナルブランド品の制作をお手伝い

ODMソリューションその① キッティングサービス Windows や Linux や貴社専用のアプリケーションのインストールなど各種キッティングサービスを行います。貴社での面倒なインストール作業を削減し、到着したその日からすぐにお使い頂けます。	ODMソリューションその② ソフトのカスタマイズ BIOS のカスタマイズ（ロゴ表示・デフォルト値の変更）や WindowsOS のイメージ作成・構築をはじめ各種アプリケーション開発のお手伝いも可能です。詳しくは弊社営業部までご相談下さい。弊社パートナーをご紹介します。	ODMソリューションその③ パネルのステッカー製作 ステッカーの製作は200枚から承ります。ステッカーを弊社でお預かりし、本体ご注文時に貼り付けて出荷致します。 
ODMソリューションその④ カラーチェンジ ケースのカラーチェンジは200台ロットより対応致します。また社名やロゴ、インターフェース名の変更も可能です。	ODMソリューションその⑤ ボードのカスタマイズ ボード上のコンポーネントの取外しや変更など、I/O や機能のカスタマイズが可能です。 	ODMソリューションその⑥ 各種認証取得 標準にて CE と FCC 認証を取得していますが、ご希望に合わせて、VCCI や UL、CCC などの取得手続きを別途行います。

LTE通信内蔵対応、モバイルネットワークで 遠隔制御・稼働監視・遠隔保守・メンテナンスを実現

LTE モジュール

SIMCom Wireless Solution社製

SIM7600JC-H-MPCleモジュール

対応回線	docomo/au/Softbank
アクセス方式	FDD-LTE
ダウンリンク	最大150Mbps (FDD-LTE)
アップリンク	最大50Mbps (FDD-LTE)
動作温度	-30～80℃

SIM7912G-M2モジュール

型式名	docomo/au/Softbank
アクセス方式	FDD-LTE/TDD-LTE
ダウンリンク	最大600Mbps (LTE)
アップリンク	最大100Mbps (LTE)
動作温度	-30～80℃

NeW

LTE 通信専用アンテナ

1

ダイポールアンテナ

2

無指向性アンテナ

ダイポールアンテナを取り付けた状態のNeu-X100

背面

メーカー	キャセイ・トライテック	
品名	1 ダイポールアンテナ	2 無指向性アンテナ
型名	JSK-4G-401	CTA-002-2m
外形寸法 (mm)	—	—
ケーブル長 (m)	—	2
動作温度	-40～70℃	
取付方法	本体に直付け	両面テープ